2017-2022年中国半导体封 装用引线框架市场竞争形势分析与投资战略研究报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制 www.abaogao.com

一、报告报价

《2017-2022年中国半导体封装用引线框架市场竞争形势分析与投资战略研究报告》信息及时 ,资料详实,指导性强,具有独家,独到,独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势, 获得优质客户信息,准确、全面、迅速了解目前行业发展动向,从而提升工作效率和效果, 是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址:http://www.abaogao.com/b/dianzi/P28941TV8U.html

报告价格:印刷版:RMB 7000 电子版:RMB 7200 印刷版+电子版:RMB 7500

智研数据研究中心

订购电话: 400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售:010-80993963

传真: 010-60343813

Email: sales@abaogao.com

联系人: 刘老师 谭老师 陈老师

特别说明:本PDF目录为计算机程序生成,格式美观性可能有欠缺;实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

报告目录:

- 第一章引线框架产品概述5
- 1.1引线框架概述5
- 1.1.1定义5
- 1.1.2引线框架在半导体封装中的应用5
- 1.1.3引线框架产品形态6
- 1.1.4引线框架产品特性与各功能结构9
- 1.2引线框架的发展历程10
- 1.2.1引线框架随着半导体封装技术发展而得到发展10
- 1.2.1.1近年的半导体封装技术发展10
- 1.2.1.2IC封装技术发展与引线框架产品结构形式的关系13
- 1.2.2当今及未来引线框架技术发展路线图15
- 1.2.3引线框架主流铜带材料的转变16
- 1.3引线框架在半导体产业发展中的重要地位17
- 1.3.1引线框架是适合半导体键合内引线连接的关键结构材料17
- 1.3.2引线框架在半导体封装中所担负的重要功效18
- 1.3.3引线框架在半导体封装的性能提高、成本控制上发挥着重要作用22

第二章引线框架产品品种、分类及性能要求25

- 2.1引线框架主流产品品种的演变25
- 2.2引线框架的品种分类26
- 2.2.1按照材料组成成分分类26
- 2.2.2按照生产工艺方式分类32
- 2.2.3按材料性能分类32
- 2.2.3.1低强高导型与中强中导型33
- 2.2.3.2高强高导型与超高强度中导型33
- 2.2.4按照使用的不同器件类别分类33
- 2.3引线框架材料的性能要求36
- 2.3.1对引线框架材料的性能要求36
- 2.3.2封装工艺对引线框架的性能要求38

- 2.4引线框架的国内外相关标准43
- 2.4.1国内相关标准43
- 2.4.2国外相关标准44

第三章引线框架的生产制造技术现况45

- 3.1引线框架成形加工两类工艺方式45
- 3.2冲制法生产引线框架46
- 3.2.1冲制法生产引线框架的工艺特点46
- 3.2.2冲制法的关键技术47
- 3.3蚀刻法生产引线框架47
- 3.3.1蚀刻法生产引线框架的工艺原理及过程48
- 3.3.2与冲制法相比的优点49
- 3.4引线框架表面电镀处理49
- 3.4.1引线框架表面电镀层的作用与特点49
- 3.4.2引线框架电镀的工艺流程及工艺条件50
- 3.4.3引线框架表面电镀加工生产线的类别51
- 3.4.4引线框架表面电镀加工工艺的发展52
- 3.4.5局部点镀技术53
- 3.4.5.1基本原理53
- 3.4.5.2轮式点镀54
- 3.4.5.3压板式点镀55
- 3.4.5.4反带式点镀56
- 3.4.6Sn系无铅可焊性镀层56
- 3.4.7PPF引线框架技术56
- 3.4.8国内厂家开发高性能引线框架的电镀技术创新例58

第四章世界引线框架市场需求现状与分析61

- 4.1世界引线框架市场规模61
- 4.2世界引线框架产品结构的变化62
- 4.3世界引线框架市场格局65
- 4.4世界引线框架市场发展及预测66
- 4.4.1世界半导体产业发展现况66

- 4.4.2世界封测产业及市场现况67
- 4.4.3世界引线框市场发展前景68

第五章世界引线框架生产现况70

- 5.1世界引线框架生产总况70
- 5.2世界引线框架主要生产企业的市场份额情况73
- 5.3世界引线框架主要生产企业的情况74
- 5.3.1住友金属矿山公司74
- ……
- 5.3.10先进半导体材料科技公司82

第六章我国国内引线框架市场需求现状84

- 6.1我国国内引线框架市场需求总述84
- 6.1.1国内引线框架市场规模84
- 6.1.2国内引线框架市场总体发展趋势85
- 6.1.3国内引线框架市场的品种结构85
- 6.2国内引线框架的集成电路封装市场情况及发展86
- 6.2.1我国集成电路产业发展现况与展望87
- 6.2.2国内引线框架重要市场之一——集成电路封装产业现况及发展88
- 6.3国内引线框架的分立器件市场情况及发展92
- 6.3.1国内分立器件产销情况93
- 6.3.2国内分立器件的市场情况94
- 6.3.3国内分立器件封装行业现况96
- 6.4国内引线框架的LED封装市场情况及发展98
- 6.4.1引线框架的LED封装上的应用98
- 6.4.2国内LED封装用引线框架行业情况101
- 6.4.3国内LED封装产业发展现况与展望103

第七章我国国内引线框架行业及主要企业现况108

- 7.1国内引线框架产销情况108
- 7.2国内引线框架生产企业总况108
- 7.3近几年在国内引线框架企业的投建或扩产情况111

- 7.4当前国内引线框架行业发展的特点与存在问题112
- 7.5国内引线框架主要生产企业情况115
- 7.5.1深圳先进微电子科技有限公司115
- ……
- 7.5.23成都尚明工业有限公司124

第八章引线框架材料市场及其生产现况126

- 8.1国内外引线框架制造业对铜带材料的性能需求126
- 8.1.1对引线框架材料的主要性能要求126
- 8.1.2引线框架材料市场在品种需求上的四个阶段的发展变化127
- 8.2引线框架材料的品种、规格及基本特性129
- 8.2.1引线框架材料的品种129
- 8.2.2引线框架制造中常用的铜合金材料品种134
- 8.2.2.1总述134
- 8.2.2.2C19200、C19400引线框架用铜合金材料136
- 8.2.2.3其它常用高性能引线框架铜合金材料136
- 8.3引线框架业对铜合金材料品种需求市场的情况138
- 8.4引线框架业对铜合金材料需求量的情况139

第九章国内外引线框架用铜合金带材生产技术发展及主要生产厂家141

- 9.1高性能引线框架铜合金材料生产技术141
- 9.1.1铜合金的熔铸技术141
- 9.1.2铜带的加工技术142
- 9.2高性能引线框架铜合金材料生产工艺与设备条件144
- 9.2.1工艺技术方面144
- 9.2.2设备条件145
- 9.2.3国外工业发达国家工艺技术与装备情况145
- 9.2.4C19400的工艺过程与技术环节要点146
- 9.2.5获得高强度高导电铜合金的工艺途径150
- 9.3国外引线框架用铜带的主要生产厂商情况153
- 9.4国内引线框架用铜带的主要生产厂商情况154
- 9.4.1我国铜及铜合金板带材的生产与需求情况154

- 9.4.2我国引线框架用铜合金带材技术开发的情况157
- 9.4.3我国引线框架用铜合金带材生产总况159
- 9.4.4我国引线框架用铜合金带材主要生产厂情况160
- 9.4.4.1中铝洛阳铜业有限公司160

……

9.4.4.7中色奥博特铜铝业有限公司164

第十章关于金属层状复合材料在引线框架领域应用前景的调查与分析166(ZYWZY)

- 10.1金属层状复合带材及其在国内的研发情况166
- 10.2金属层状复合材料的引线框架领域应用前景的调查与分析169
- 10.2.1金属层状复合材料在引线框架领域应用的可行性169
- 10.2.2对国外同类产品及其应用的的调查170
- 10.2.3对金属层状复合材料的引线框架领域应用前景调查171
- 10.2.4对金属层状复合材料的引线框架领域市场情况的分析172

图表目录:

- 图1-1引线框架在半导体集成电路封装中的应用
- 图1-2引线框架产品实例
- 图1-3DIP8引线框架图
- 图1-4SOP16引线丰匡架图
- 图1-5PQFP44引线框架图
- 图1-6引线框架结构的封装例及引线框架功能结
- 图1-7半导体封装形式及技术的发展情况
- 图1-8引线框架未来技术发展路线图
- 图1-9从IC封装工艺过程看引线框架在其中的重要功效
- 图1-10引线框架-陶瓷基板式IC封装的工艺过程
- 图1-11有机封装基板式IC封装的工艺过程
- 图1-121988年~2016年世界半导体封装材料市场规模的变化
- 图1-132016年全球IC封装材料市场份额
- 图2-1引线框架与小基岛匹配
- 图2-2典型的DIP引线框架锁定设计
- 图2-3引线框架应力与释放

- 图2-4引线框架镀银区
- 图2-5内引脚间隙不一致
- 图2-6吊筋
- 图3-1冲制法与蚀刻法生产工艺流程
- 图3-2引线框架表面电镀技术的发展历程
- 图3-3选择性喷镀装置示意图及采用局部点镀的IC引线框架样品照片
- 图3-4局部喷镀轮结构
- 图3-5压板式局部喷镀结构
- 图3-6PPF框架构成及含有PdPPF层的IC封装结构
- 图4-12003~2016年全球及国内引线框架市场规统计
- 图4-2对应各种封装形式的增长率
- 图4-32009~2016年世界引线框架产品结构变化
- 图4-42016年世界引线框架市场的格局情况
- 图4-5按照国家、地区统计的主要企业所生产引线框架所占市场份额情况
- 图4-62007~2016年全球封测产业产值变化
- 图5-12016年全球蚀刻型引线框架生产厂商市场份额
- 图5-22016年全球冲制型引线框架生产厂商市场份额
- 图5-3世界主要引线框架企业生产情况及其市场份额

更多图表见正文......

详细请访问: http://www.abaogao.com/b/dianzi/P28941TV8U.html